

证券代码：831055

证券简称：三优光电

主办券商：申万宏源

厦门三优光电股份有限公司

对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因联合申请科技项目需要，公司为厦门紫硅半导体科技有限公司（以下简称“紫硅半导体”）的项目自有资金人民币伍佰万元（¥500万元）提供连带责任担保，同时，紫硅半导体控股股东张峰以其名下全部资产为本担保事项作连带责任反担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2019年9月24日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：厦门紫硅半导体科技有限公司

住所：厦门火炬高新区创业园伟业楼南楼 301E 室

注册地址：厦门火炬高新区创业园伟业楼南楼 301E 室

注册资本：5,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：申占伟

主营业务：工程技术研究和试验发展、电子工业专用设备制造、其他电子设备制造、其他质检技术服务、特种设备检验检测、信息技术咨询服务等。

成立日期：2019 年 7 月 8 日

2、被担保人信用状况

2019 年 8 月 31 日资产总额：47,894.44 元

2019 年 8 月 31 日流动负债总额：10,615.00 元

2019 年 8 月 31 日净资产：37,279.44 元

2019 年 8 月营业收入：0 元

2019 年 8 月税前利润：-22,720.56 元

2019 年 8 月净利润：-22,720.56 元

三、担保协议的主要内容

公司与紫硅半导体共同向厦门市科技局申请了“碳化硅功率器件/模块研发及其在光伏逆变器中的应用”项目，其中紫硅半导体应承担自有资金人民币伍佰万元（¥500 万元），目前紫硅半导体自有资金尚未到账。

公司承诺，项目立项成功后，如 2021 年 6 月底前紫硅半导体的自有资金仍未在该项目中到位，公司愿为上述人民币伍佰万元（¥500 万元）资金或其剩余部分资金提供连带责任保证担保。同时，紫硅半导体控股股东张峰以其名下全部资产为本担保事项作连带责任反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

厦门紫硅半导体科技有限公司是以中科院半导体研究所 SiC 研究团队为基础而成立的高新技术科技公司，已在碳化硅半导体同质外延材料生长，材料物理，物性分析，微细加工技术及电力电子器件结构与研制等方面做出了出色的工作，已建立了 SiC 材料和器件的研究基础。

此团队 2019 年 7 月份在厦门成立厦门紫硅半导体科技有限公司，注册资金尚未到位，此次和我司共同申报厦门市重大专项科研项目，会推动公司 SiC 项目的快速发展。

董事会在考虑共同发展和风险可控的基础上同意为厦门紫硅半导体科技有限公司提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，第三代半导体材料是厦门市重点发展产业，厦门市政府鼓励和支持本地企业形成产业链，公司和厦门成立厦门紫硅半导体科技有限公司的合作，有利于公司未来的发展；同时，厦门紫硅半导体科技有限公司控股股东张峰以其名下的全部资产为本项担保提供反担保，因此，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		500	100%
其中	逾期担保累计金额	0	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 4.47%。

六、备查文件目录

（一）公司《第三届董事会第九次会议决议》。

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2019年9月26日